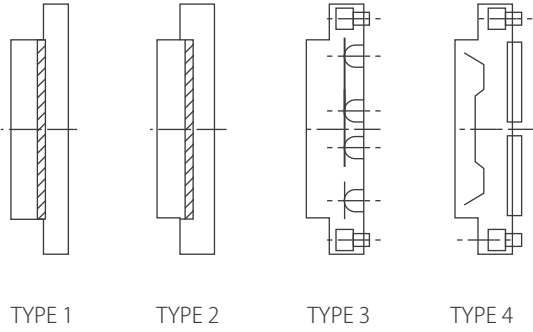


各種スパッタリングターゲット

SPUTTERING TARGET

ターゲット形状大別



パッキングプレート 一体型

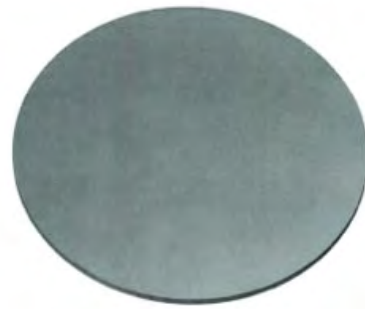
材質 W Mo Al



材質 W Mo Al 各種合金



材質 W Mo Al 各種合金



スパッタリングターゲットの用途と材質

APPLICATION AND MATERIAL OF SPUTTERING TARGET

用途 Application	材質 Material
半導体 Semiconductor	<input checked="" type="checkbox"/> Al <input type="checkbox"/> Pure Al 4N / 5N / 6N <input type="checkbox"/> Al 合金 (Al Alloy) Al + Si / Al + Si + Cu / Al + Cu
電子部品 Electronic Parts	Al + Mg / Al + Ti / Ta / Al + 希土類 (Rare earth metal) その他 Al 母体合金のご注文も承ります。(In addition, Al alloys are also available.)
液晶 Liquid Crystal	<input checked="" type="checkbox"/> Pure Ta <input checked="" type="checkbox"/> Pure Mo
光学部品 Optical Parts	<input checked="" type="checkbox"/> Pure W <input checked="" type="checkbox"/> Mo + W (70:30)
その他 Other	<input checked="" type="checkbox"/> Ti <input checked="" type="checkbox"/> Ni <input checked="" type="checkbox"/> Cr <input checked="" type="checkbox"/> Nb



その他各種合金の真空溶解、真空鋳造を受託しております。サイズについては、ご用命にお応えしますので、ご相談下さい。